

# 2018年度 京セラ株式会社 募集要項

## 1. 採用予定

- 【応募資格】 2018年3月 四年制大学卒業及び大学院修了見込みの方  
(浪人・留年については原則として計2年以内を目安とさせていただきます)
- 【採用予定】 理工系 160名 程度
- 【採用学科】 電気・電子系／情報・通信系／機械系／制御系／物理系／化学系／材料系／その他(知的財産 他)
- 【求める人材像】
- ・ 夢に向かって果敢にチャレンジし続けられる人
  - ・ 素直な心、ひたむきさを持っている人
  - ・ グローバルな視点を持っている人
- (今後の事業のグローバル展開を踏まえ、目安としてTOEIC600点相当の語学力がある方は、更に歓迎します)

(専攻分野と採用比率目安)

電気・電子／情報・通信系	機械／制御系	化学／材料系	物理系	その他
30%	30%	30%	5%	5%

## 2. 応募方法

### (1) 修士・学部の方の応募方法について

次の2コース(プロダクト別採用コース/職種別採用コース)よりご選択いただき、ご応募ください。

※コースの併願はできませんので、ご了承ください。

※各プロダクト・職種の詳細、応募方法の詳細は添付別紙「応募に際しての留意事項」及び「応募概要」をご参照ください。

#### 【1】プロダクト別採用コース(対象:学校推薦応募者限定)

弊社へ学校推薦応募を検討されている方は、ご本人の「希望される弊社プロダクト」「技術専門性・応用性」(学部生の場合は「学業の理解度とポテンシャル」)について、弊社該当部署との適性を事前に「マッチング面談会」にて確認させていただきます。面談にて、マッチングが成立したプロダクト担当部署への配属を前提に、その後の選考に進んでいただきます。※①～⑭のうち、2つのプロダクト(第1希望/第2希望)をご選択ください。※6月1日以降にご応募いただいた場合には、配属先のプロダクトを限定しない採用方法に変更させていただく可能性があります。ご了承下さい。

対象プロダクト:

- |                           |                                  |                |             |
|---------------------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| ①ファインセラミック部品              | ②車載用部品・車載カメラ                     | ③セラミックパッケージ・基板 | ④有機パッケージ・基板 |
| ⑤ケミカル材料                   | ⑥切削工具                            | ⑦医療機器          | ⑧宝飾・応用商品    |
| ⑨エネルギーデバイス・システム(SOFC・EMS) | ⑩電子部品(コンデンサ、コネクタ、パワーデバイス、水晶デバイス) | ⑪ソフトウェア開発      | ⑬生産技術開発・精機  |
| ⑫プリンティングデバイス              | ⑭通信機器                            |                |             |

※研究開発部門につきましては、①～⑭は、各プロダクト部門の中に含まれています。

#### 【2】職種別採用コース(対象:学校推薦・自由応募者どちらでも可)

次の職種においては、職種別に適性マッチングを確認し、該当部門への配属を前提に、その後の選考に進んでいただきます。

※⑮～⑰のうち、1つの職種のみをご選択ください。

対象職種: ⑮特許・知的財産 ⑯情報ネットワーク・システムエンジニア ⑰施設管理 ⑱安全防災

### (2) 博士の方の応募方法について

ご応募を検討される際は、ご本人からのご連絡をお願いいたします。応募時に、まず論文審査をさせていただきます。

履歴書並びに専門分野に関する論文を弊社担当宛にご郵送ください。論文審査合格の方に、選考のご案内をさせていただきます。

※博士課程の方については随時受付いたします。

### (3) 理工系の知識を活用する「営業職」への推薦応募方法について

京セラでは、理工系の知識を活用して「営業職」として活躍いただける方についても、別途推薦でのご応募を受け付けております。

応募・選考方法が通常と異なりますので、ご希望の場合には弊社担当宛にご連絡ください。

### (4) 留学生の方の応募方法について

学校推薦で応募を希望される場合には、事前に弊社担当宛にご相談ください。

### (5) 自由応募の方の応募方法について

応募コース、選考方法が学校推薦応募方法と異なります。

弊社HPのマイページをご確認の上、ご応募ください。

#### <技術系採用書類送付・お問い合わせ先>

〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地  
京セラ株式会社 人材開発課(技術採用担当) 田中・今野  
E-mail: misato.tanaka.nf@kyocera.jp, konno.shingo.yb@kyocera.jp  
TEL: 075-604-3510 (直通)  
※各コースへの応募書類ご郵送の際は、封筒に「〇〇採用コース応募書類在中」と記載願います

京セラへの応募をお考えの方は

『京セラ プロダクト・職種別合同セミナー』へぜひ、ご参加ください！各プロダクトより、事業内容や最先端技術をご紹介します！HPのマイページからご予約下さい。

【全国3か所で開催】

東京 3月23日・24日、4月4日・5日 ※3月23日は機電情限定  
京都 3月22日・26日  
博多 3月20日